

# EFEM(Equipment Front End Module) 晶圆移载模组



# EFEM320-D01

SEMI S2(EFEM320系列) APPROVED

支援8吋SMIF规格

## 特色

- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。

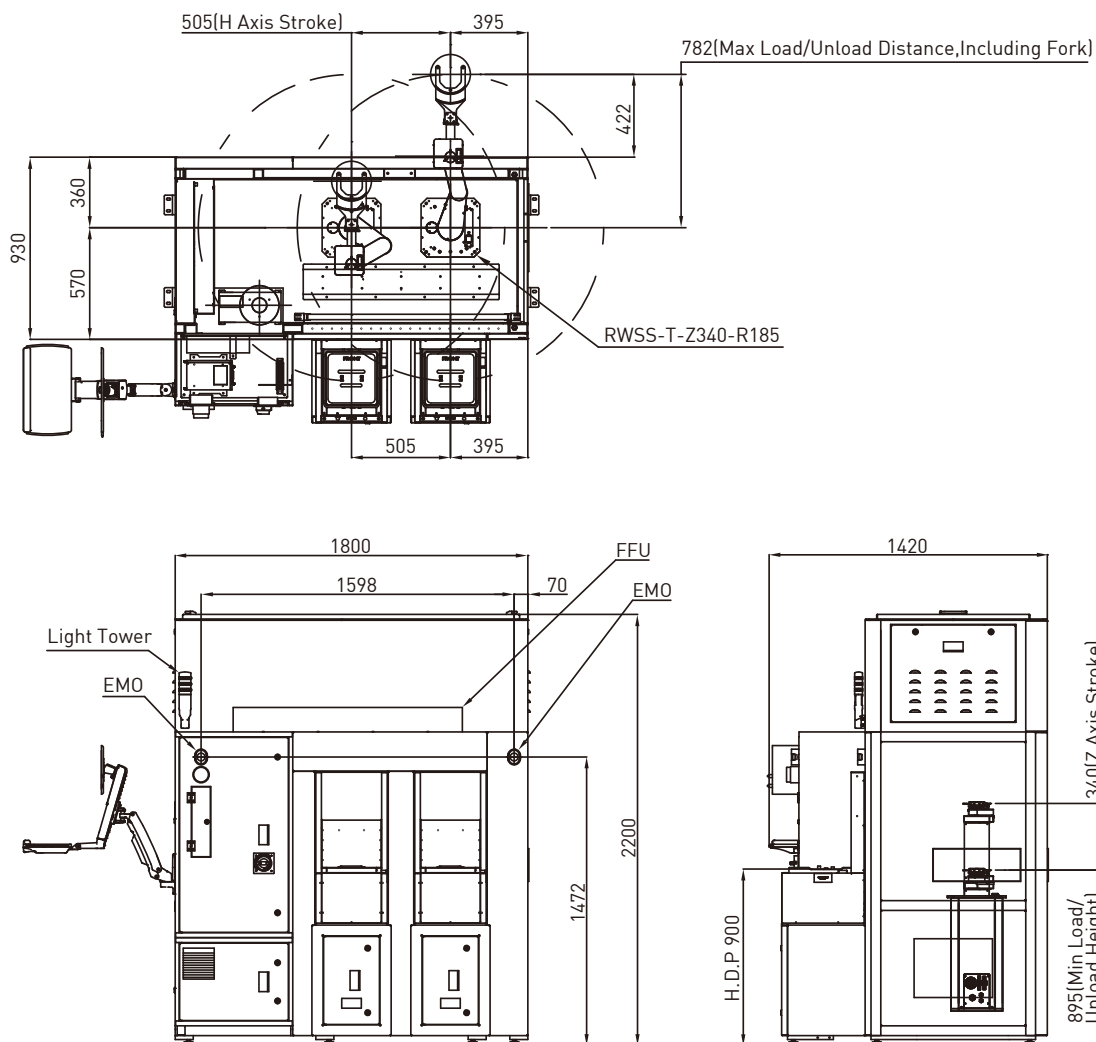


外观尺寸 / 运动范围

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWSS-T-Z340-D5R185
取放距离	422mm
晶圆	200mm、warpage $\pm 1$ mm、8"厚度500-1000 $\mu$ m
重复精度	$\pm 0.1$ mm
机台尺寸	1420mm X 1800mm X 2200mm
洁净度	Class1 @ 0.12 $\mu$ m
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。



# EFEM320-D02

SEMI S2(EFEM320系列) APPROVED

支援8吋、12吋Wafer规格



外观尺寸 / 运动范围

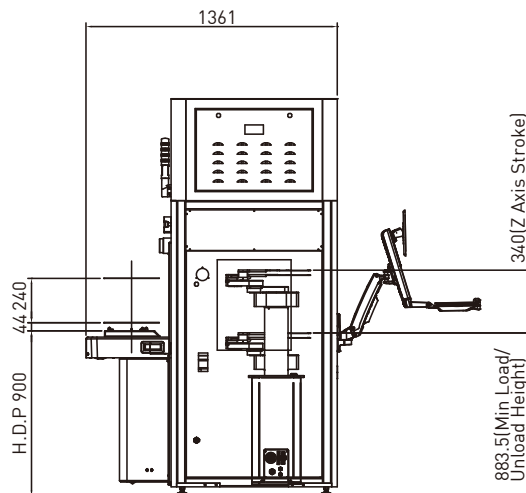
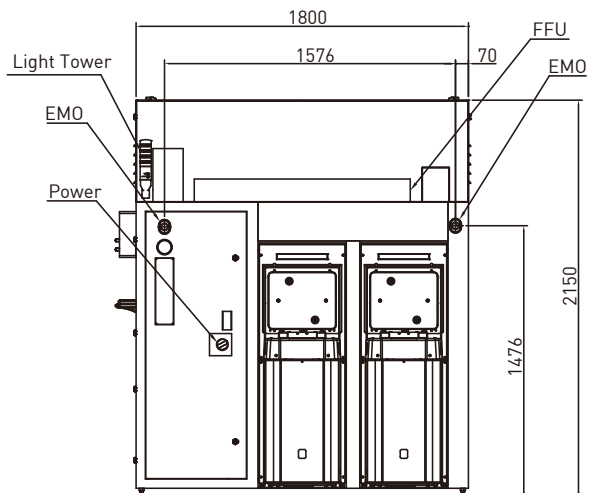
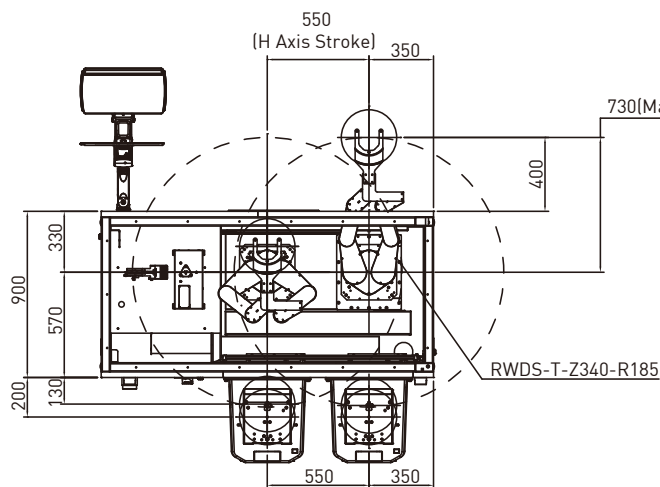
## 特色

- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWDS-T-Z340-D5R185
取放距离	400mm
晶圆	200/300mm、warpage $\pm 1$ mm、8"厚度500-1000 $\mu$ m、12"厚度650-1200 $\mu$ m
重复精度	$\pm 0.1$ mm
机台尺寸	1361mm X 1800mm X 2150mm
洁净度	Class1 @ 0.12 $\mu$ m
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。

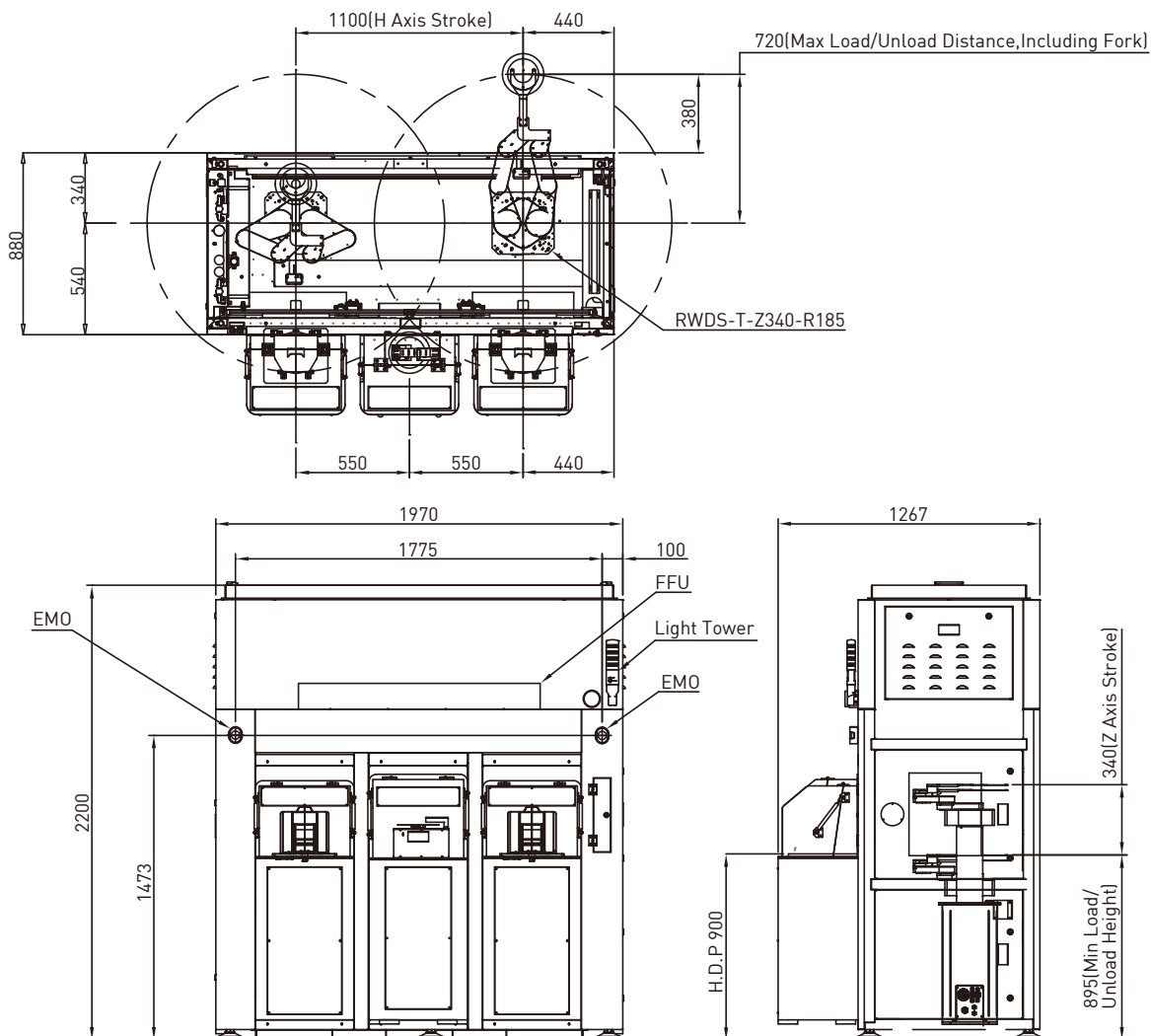


# EFEM220-D03

支援6吋、8吋Wafer规格



外观尺寸 / 运动范围



## 特色

- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。
- 符合SEMI S2设计标准。

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWDS-T-Z340-D5R185
取放距离	380mm
晶圆	150/200mm、warpage $\pm 1$ mm、6"厚度400-600 $\mu$ m、8"厚度500-1000 $\mu$ m
重复精度	$\pm 0.1$ mm
机台尺寸	1267mm X 1970mm X 2200mm
洁净度	Class1 @ 0.12 $\mu$ m
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

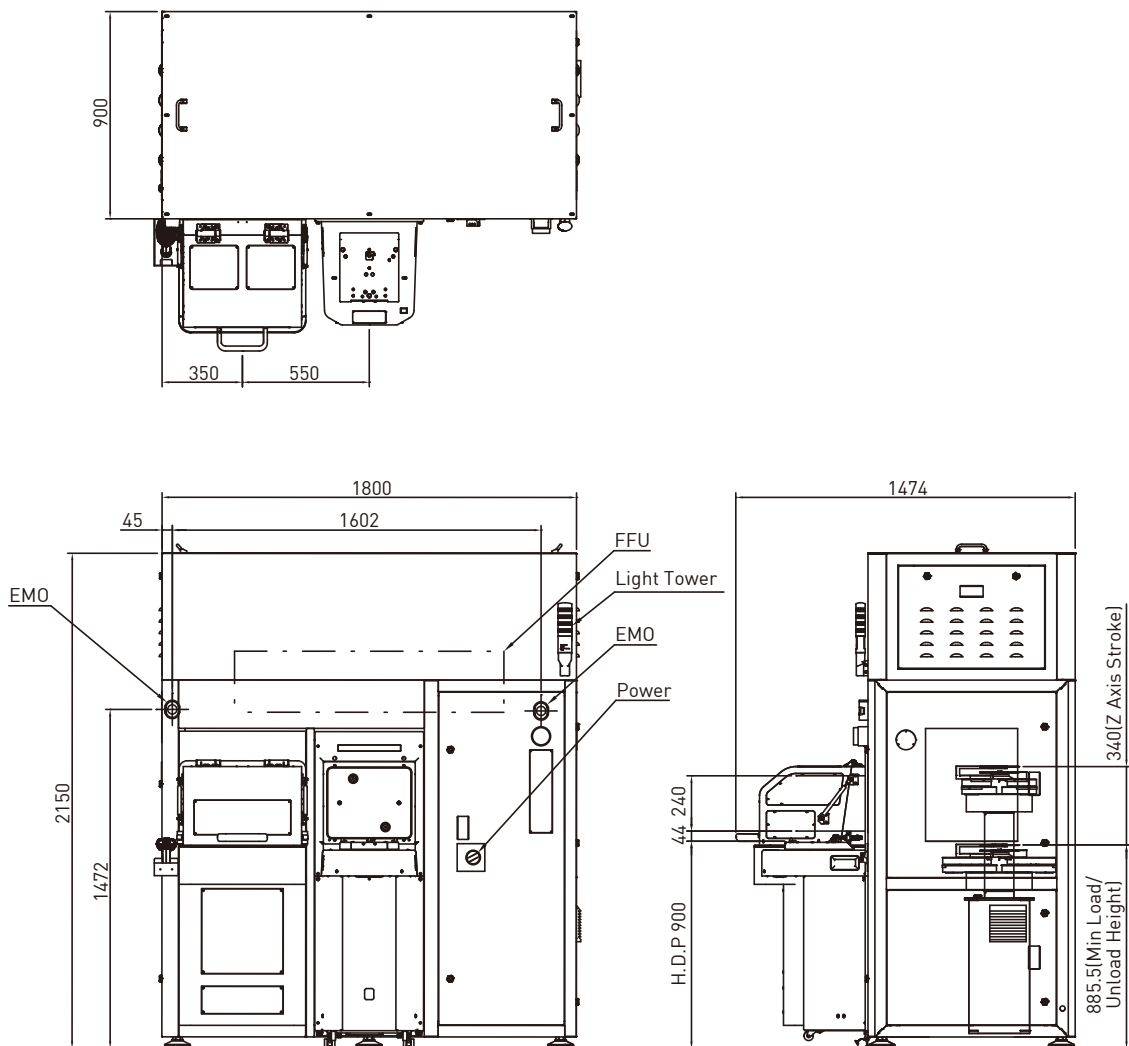
注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。

# EFEM420-D04

支援8吋、12吋Wafer及8吋、12吋Frame规格



外观尺寸 / 运动范围



## 特色

- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。
- 符合SEMI S2设计标准。

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWDS-T-Z340-D5R185 (上臂真空模组、下臂夹持模组需更换对应尺寸)
晶圆	200/300mm、warpage $\pm 1$ mm、 8"厚度500~1000 $\mu$ m、12"厚度650~1200 $\mu$ m
铁框	200/300mm、warpage $\pm 1$ mm、厚度1600mm
重复精度	$\pm 0.1$ mm
机台尺寸	1474mm X 1800mm X 2150mm
洁净度	Class1 @ 0.12 $\mu$ m
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。

# EFEM320-D06

SEMI S2(EFEM320系列) APPROVED

支援12吋Wafer及12吋Metal Carrier规格



## 特色

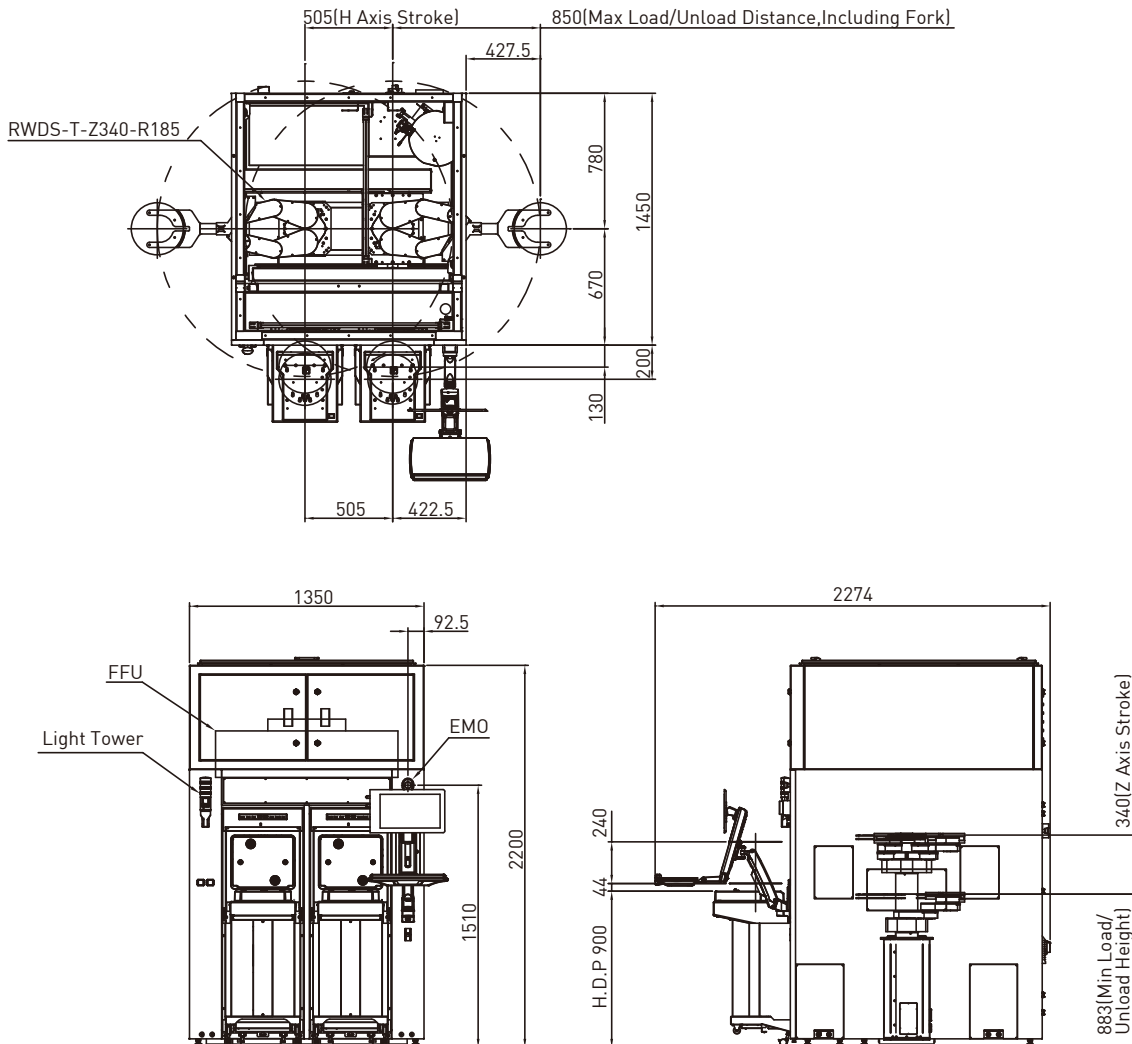
- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供定制化晶圆或其它基板搬运需求。

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWDS-T-Z340-03R185
取放距离	427.5mm
晶圆	300mm、warpage $\pm 1\text{mm}$ 、 12"厚度650-1200 $\mu\text{m}$
金属载盘	300mm、warpage $\pm 1\text{mm}$ 、厚度1600 $\mu\text{m}$
重复精度	$\pm 0.1\text{mm}$
机台尺寸	2274mm X 1350mm X 2200mm
洁净度	Class1 @ 0.12 $\mu\text{m}$
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。

## 外观尺寸 / 运动范围



# EFEM120-D07

支援8吋、12吋Frame规格



## 特色

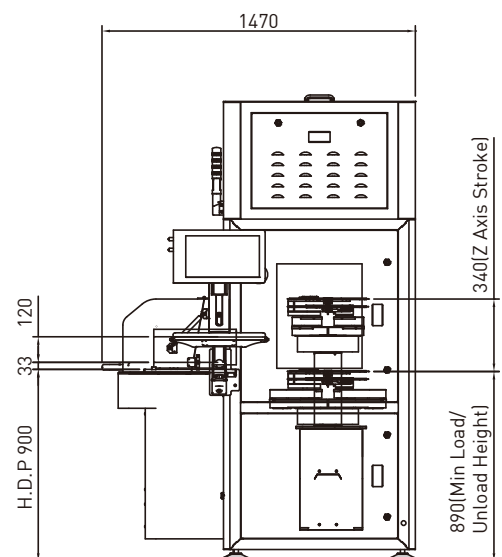
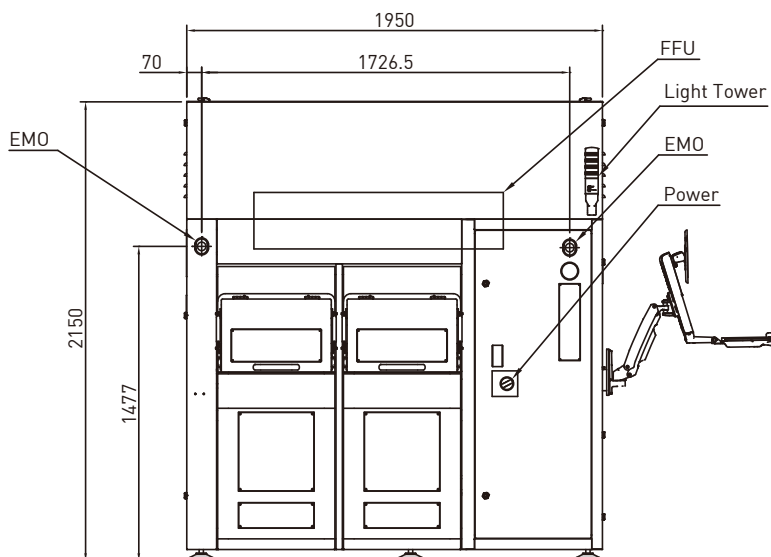
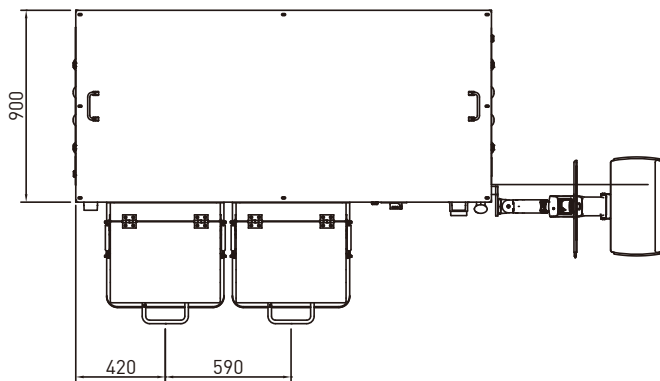
- 条码、标签及字元辨识，完整追踪生产历程。
- 提供即时影像监控。
- 高效净化及静电消除等微环境控制，确保传送过程中不受污染。
- 自动压力控制系统可以通过环境压力变化，调节风扇转速以保持设定值。
- 提供客制化晶圆或其它基板搬运需求。
- 符合SEMI S2设计标准。

项目	规格
埠数	2埠
手臂型号	RWDS-T-Z340-03R185 (夹持模组需更换对应尺寸)
铁框	200/300mm、warpage±1mm、厚度1600μm
重复精度	±0.1mm
机台尺寸	1470mm X 1950mm X 2150mm
洁净度	Class1 @ 0.12μm
电源	1 phase, 220VAC, 25A
流量	正压100L/min, 负压50L/min
选配	晶圆ID读取器 条码读取器 无线射频标签读取器 E84模组 静电消除器 SECS/GEM通讯

\* 注一：上述规格皆不含选配项目。

注二：SECS/GEM须由系统商与当地软件公司合作开发。

外观尺寸 / 运动范围



## 全球销售暨服务据点

### 德国 欧芬堡

HIWIN GmbH  
OFFENBURG, GERMANY  
www.hiwin.de  
www.hiwin.eu

### 意大利 米兰

HIWIN Srl  
BRUGHERIO, ITALY  
www.hiwin.it

### 新加坡

HIWIN SINGAPORE  
SINGAPORE  
www.hiwin.sg

### 日本 神户·东京·名古屋·长野· 东北·静冈·北陆·广岛· 福冈·熊本

HIWIN JAPAN  
KOBE · TOKYO · NAGOYA · NAGANO ·  
TOHOKU · SHIZUOKA · HOKURIKU ·  
HIROSHIMA · FUKUOKA · KUMAMOTO,  
JAPAN  
www.hiwin.co.jp

### 瑞士 优纳

HIWIN Schweiz GmbH  
JONA, SWITZERLAND  
www.hiwin.ch

### 韩国 水原·昌原

HIWIN KOREA  
SUWON · CHANGWON, KOREA  
www.hiwin.kr

### 捷克 布尔诺

HIWIN s.r.o.  
BRNO, CZECH REPUBLIC  
www.hiwin.cz

### 以色列 海法

Mega-Fabs Motion  
Systems, Ltd.  
HAIFA, ISRAEL  
www.mega-fabs.com

### 美国 芝加哥

HIWIN USA  
CHICAGO, U.S.A.  
www.hiwin.com

### 法国 斯特拉斯堡

HIWIN FRANCE  
STRASBOURG, FRANCE  
www.hiwin.fr

# HIWIN® 上银®

## 中国子公司

### 上银科技(中国)有限公司

HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP.  
江苏省苏州市苏州工业园区夏庄路2号

Tel : (0512) 8068-5599  
Fax: (0512) 8068-9858  
www.hiwin.cn  
business@hiwin.cn

## 全球营运总部

### 上银科技股份有限公司

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.  
www.hiwin.tw  
business@hiwin.tw

### 大银微系统股份有限公司

HIWIN MIKROSYSTEM CORP.  
www.hiwinmikro.tw  
business@hiwinmikro.tw

- HIWIN为上银科技的注册商标，请勿购买来路不明之仿冒品以维护您的权益。
- 本型录所载规格、照片有时会与实际产品有所差异，包括因为改良而导致外观或规格等发生变化的情况。
- HIWIN产品专利清单查询网址：[http://www.hiwin.tw/Products/Products\\_patents.aspx](http://www.hiwin.tw/Products/Products_patents.aspx)
- 凡受“贸易法”等法规限制之相关技术与产品，HIWIN将不会违规擅自出售。若要出口HIWIN受法律规范限制出口的产品，应根据相关法律向主管机关申请出口许可，并不得供作生产或发展核子、生化、飞弹等军事武器之用。

本型录的内容规格若有变更，恕不另行通知。

Copyright © HIWIN Technologies Corp.

©2021 FORM C28DS01-2103 (PRINTED IN TAIWAN)